

展覽日期	2023年11月7日至10日(星期二至星期五)
主辦單位	德國美賽高法蘭克福公司 (Mesago Messe Frankfurt GmbH)
組團單位	法蘭克福展覽(香港)有限公司 (Messe Frankfurt (HK) Ltd.)
支持單位	台灣區電機電子工業同業公會 (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association) (公會將規劃向經濟部國際貿易局申請展覽補助, 如參展規模未達5個攤位將不組團、不補助)
台灣聯繫單位	香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 (Messe Frankfurt (HK) Ltd. Taiwan Branch Office)
展覽地點	德國法蘭克福展覽會場 (Messe Frankfurt GmbH Fair Ground)
展出項目	模具製造及加工、增材製造、3D 列印及技術、量具及夾具製造、快速製造、手板製作及快速成型、加工機械及工具、自動化系統及自動化工程、刀具、切削工具及配件、表面處理技術、生產工程、材料(鋼材、銅材、合金、粉末等)、配件(熱流道、標準件、感測器等)、廠房設備、工業設計、檢測及品質控制、設計軟體、生產管理軟體、測試用生產設備和系統、研究和開發、人才培訓及資格認證、輔料(潤滑油、電介質等)
參展費用	<ul style="list-style-type: none"> ● 標準套裝攤位參展費用(最小租用面積 12 平方公尺) <ul style="list-style-type: none"> 1. 一面開攤位(最小面積 12 平方公尺), 歐元 515/每平方公尺 2. 兩面開攤位(最小面積 20 平方公尺), 歐元 540/每平方公尺 <p style="margin-left: 20px;">* 攤位費用包含空地租金及基本裝潢; 配備及傢俱數量按攤位大小增減。</p> <p style="margin-left: 20px;">>基本裝潢: 以 12 平方公尺為一基本單位 (本公司有權因設計變動更換下列配備)</p> <p style="margin-left: 20px;">基本搭建、公司招牌、地毯、隔間、投射燈、會議桌、會議椅、可鎖櫃、玻璃展示櫃、紙屑筒、100W 電源插座 1 個 (220V) 僅供手提電腦使用、基本電力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Semi-Package 參展費用(最小租用面積 24 平方公尺) <ul style="list-style-type: none"> 1. 一面開攤位 (最小面積 24 平方公尺), 歐元 465/每平方公尺 2. 兩面開攤位 (最小面積 24 平方公尺), 歐元 490/每平方公尺 <p style="margin-left: 20px;">* 攤位費用含空地租金以及基本電力 3kW</p> ● 參展商必須同時加入大會 Sales & Marketing Services (SMS) Package:1,140 歐元起, 本費用包含紙本/電子/手機參展名錄、買主邀請、媒體與社群活動宣傳、現場推廣等增值服務。 ● 參展保證金, 報名時需要參展保證金支票, 金額依所訂攤位大小詳列如下: <ul style="list-style-type: none"> 12 ~ 19 sqm – 新台幣 壹拾萬 元整 20 ~ 29 sqm – 新台幣 貳拾萬 元整 30 ~ 39 sqm – 新台幣 參拾萬 元整 40 sqm 以上 – 新台幣 肆拾萬 元整 <p style="margin-left: 20px;">請依照所訂面積按照上述金額開立 禁背支票 寄予本公司</p> <p style="margin-left: 20px;">抬頭: 香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司</p> <p style="margin-left: 20px;">到期日: 2023 年 7 月 30 日</p> <p style="margin-left: 20px;">參展費用於收到場租發票 Invoice, 依照發票上所訂之繳款截止日前足額到匯至指定境外帳戶, 並將水單或匯款電文傳真予本公司核銷款項; 本公司確認收訖後, 將保證金支票原票無息退回。</p>
報名及付款方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請填妥台灣團報名表後 (務必蓋上公司章), 先行傳真至本司 02-27476656, 然後將『報名表正本』及『參展保證金支票』於7日內掛號郵寄回本公司 (110台北市市民大道6段288號8樓 法蘭克福展覽公司 Formnext收), 才算完成報名程序; 逾期視同未完成報名程序。 2. 根據德國大會參展規定, 參展商一經報名即無法退展, 我司收到報名表後, 將立即跟大會申請攤位, 並由德國按照產品屬性直接安排攤位。 3. 匯款帳戶於Invoice內註明。匯款完成後請將「水單」或「匯款電文」傳真予本公司對帳。

參展補助	<ul style="list-style-type: none">● 本展獲『台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）』申請經濟部貿易局參展補助，廠商符合各項報名、付款及攤位搭建規定，方可獲得補助。● 需符合補助規定，若參展規模未達 5 個攤位，公會將不組團及不補助。● 此補助方案，廠商除了填寫本（法蘭克福展覽有限公司台灣）公司的報名表格外，還需填寫電電公會報名表格；● 欲獲得此方案之廠商，攤位費用將由電電公會代收代付，以符合貿易局規定；● 廠商須遵守電電公會報名、收款、核銷及台灣廠商識別標誌放置規定，若無法配合，公會將無法協助取得補助款，鑒請 了解！
取消參展	➤ 一經遞交報名表格後，根據大會規定將無法退展，若申請退展，將全額兌現保證金支票！！
相關服務	<ul style="list-style-type: none">➤ 本公司將提供相關配合單位之各項服務資訊以便廠商聯繫。➤ 本公司會儘速並不定期提供大會發佈之最新消息及資訊。
備 註	<ul style="list-style-type: none">● 詳細之完整參展辦法與規定，請參閱本公司網址：www.messefrankfurt.com.hk● 請注意：參展費用一經報名後，除非主辦單位宣告取消展會，否則展會費用不予退還及移轉(旅遊限制不構成退費/轉展條件)。如主辦單位因天災、疫情或各國政府防疫規範而須另擇他日舉辦展會，參展公司須配合出席並不得申請退費/轉展。

台灣聯繫單位請洽：

香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 林培皓 Jason 先生
110 台北市市民大道6段288號8樓
電話：(02) 8729 1099 ext. 326 傳真：(02) 2747 6656
Email：jason.lin@taiwan.messefrankfurt.com

台灣區電機電子工業同業公會 康奕婷 Tiffany Kang 小姐
11490 台北市內湖區民權東路六段109號8樓
電話：(02) 8792 6666 ext. 247 傳真：(02) 8792 6141
Email：tiffany@teema.org.tw

2023 formnext 法蘭克福國際精密成型暨3D列印製造展

公司基本資料：用於大會名錄刊登，請確認填寫無誤。

公司統編	*請注意：公司統編需與下方之公司中、英文名稱相符		
公司名稱	中文		
	英文		
公司地址	中文	() 郵遞區號	
	英文		
電話		傳真	
Email		Website	
負責人	中文姓名		英文姓名
公司社群媒體帳號			
LinkedIn		Xing	
Twitter		Other	

展覽業務聯絡人資料：

中文姓名		分機	
英文姓名		Email	

發票資料：請勾選及於適當處填寫 同上一列公司資料 需另行開立如下

*請注意：場租發票開立之收受者僅限於香港、中國及台灣三地登記之企業，其他海外地區恕無法開立發票。

欲開立發票予香港公司者，上述公司資料、刊登資料及下列發票抬頭、地址須全數一致。

發票英文抬頭	
發票英文地址	

攤位面積需求：

<input type="checkbox"/> 標準套裝攤位 <input type="checkbox"/> Semi-Package	需求面積：_____平方公尺	<input type="checkbox"/> 一面開 <input type="checkbox"/> 兩面開/轉角
--	----------------	---

標準套裝攤位參展費用：最小租用面積 12 平方公尺，可以 3 的倍數遞增

1. 一面開攤位 (min. 12sqm)，歐元 515 / 每平方公尺
2. 兩面開攤位 (min. 20sqm)，歐元 540 / 每平方公尺

➔ 含基本裝潢配備，傢俱數量按攤位大小增減。

Semi-Package 參展費用：最小租用面積 24 平方公尺

1. 一面開攤位 (min. 24sqm)，歐元 465 / 每平方公尺
2. 兩面開攤位 (min. 24sqm)，歐元 490 / 每平方公尺

➔ 攤位費用包含基本電力，但不包含基本裝潢家具。

參展商必須同時加入大會 Sales & Marketing Service Package：歐元 1,140 起，另有升級版服務，請洽承辦人。

展出產品屬性：

	1 Design & product development		3.5 Personal protective equipment
	設計及產品開發		3.6 Cleaning devices
	1.1 Industrial Design		3.7 Capacity planning software
	1.2 Engineering and Part Design		3.8 Material management software
	1.3 PLM-and CAD-Software		4 Solution for additive manufacturing
	1.4 Optimization Service		積層製造/3D 打印
	1.5 Simulation		4.1 Data preparation software and control software
	1.6 Digitizing of components		4.2 Powder Bed Fusion
	1.7 Intellectual property protection for technology and software		4.3 Directed Energy Deposition
	2 Materials		4.4 Material Extrusion
	原物料		4.5 Binder Jetting
	2.1 Metals		4.6 Material Jetting
	2.1.1 Powders		4.7 Photopolymerization
	2.1.2 Wires		4.8 Sheet Lamination
	2.1.3 Blocks, plates, rods		4.9 Hybrid Manufacturing Cells
	2.1.4 Pastes		4.10 Vacuum casting machines and investment casting machines
	2.1.5 Miscellaneous		4.11 Processing of fibre-reinforced materials
	2.2 Polymers		4.12 Miscellaneous Systems and Machines
	2.2.1 Powders		5 Solutions for component processing
	2.2.2 Filaments		零組件處理
	2.2.3 Fluids		5.1 CAM-Software
	2.2.4 Pellets		5.2 Process simulation
	2.2.5 Miscellaneous		5.3 Operation and production organization software (ERP, PPS, BDE...)
	2.3 Ceramics		5.4 Milling, turning, grinding
	2.3.1 Powders		5.5 Sawing
	2.3.2 Pastes		5.6 Electric discharge machining
	2.3.3 Miscellaneous		5.7 Laser material processing
	2.4 Biomaterials		5.8 Water jet ablation
	2.5 Fibre-reinforced materials		5.9 Support removal
	2.6 Additives, Binder, Agents		5.10 Heat Treatment
	2.7 Standard Parts		5.11 Solutions for automated production
	2.8 Expendables		5.12 Cutting Tools and Accessories
	2.9 Miscellaneous Materials		5.13 Optimization of Production Processes
	3 Manufacturing preparation/Pre-processing		6 Solutions for surface treatment
	生產計畫及規劃		表面處理
	3.1 Material analysis		6.1 Blasting
	3.2 Material handling and storage		6.2 Honing, lapping, polishing
	3.3 Material logistics		6.3 Laser surface treatment
	3.4 Protective devices for hazardous substances		

6.4 (Electro) chemical ablation		8.1 Digitization and Software
6.5 Coating, varnishing		8.2 Industrial Tool and Die Making
6.6 Dyeing		8.3 Engineering
6.7 Wrokpiece cleaning		8.4 Production of components and assemblies
7 Quality Management/Metrology		8.5 Pattern Making
品管及度量		8.6 Prototyping
7.1 Quality assurance software		8.7 Gauge- and Fixture Manufacturing
7.2 Component and process qualification		8.8 Try-out and component testing
7.3 Measurement and analysis software		8.9 Miscellaneous production technologies
7.4 3D metrology		8.10 Data and IT security, protection of Intellectual property
7.5 Production metrology		9 Apprenticeship, Training and Qualification
7.6 Surface metrology		人才培訓及各項認證
7.7 Process monitoring		10 Research and Development (R&D)
7.8 Sensors and actuators		研發
7.9 Miscellaneous Metrology		11 Organizations and Publishing Companies
8 Digitization/Service/Tool and Die Making		公協會及媒體
相關製程-數位化/工具模具		

☐ 本次展覽一切資料與大會刊登資料等皆以此報名表上所載為準，請確認以上填寫內容無誤後於下方適當處蓋立公司大章及負責人印章(或簽名)。

☐ 請注意：公司大小章必須與報名表上申請公司名稱相符。

感謝 貴公司對本公司展覽的支持，參加法蘭克福展覽公司所舉辦之 2023 年法蘭克福國際精密成型暨 3D 列印製造展(formnext 2023)，必須同意下列事項：

- 一、 已確實瞭解，並願意確實遵守本展大會及組團單位之參展辦法及有關規定。詳細規定與辦法可參閱網址 – www.messefrankfurt.com.hk
- 二、 保證不與其他非團員之公司共用攤位或私自轉售攤位，違者除立即停止展出外，其所繳交之費用亦不予退回；此後凡法蘭克福展覽公司所舉辦之展覽皆謝絕參加。
- 三、 保證展出之產品不侵犯國內外其他廠商之專利權或商標，或其他智慧財產權。參展期間如經權責單位合法程序提出之侵權案件，相關之展品必須由攤位上撤除。
- 四、 **請注意：參展費用一經報名後，除非主辦單位宣告取消展會，否則展會費用不予退還及移轉(旅遊限制不構成退費/轉展條件)。如主辦單位因天災、疫情或各國政府防疫規範而須另擇他日舉辦展會，參展公司須配合出席並不得申請退費/轉展。**
- 五、 本公司聯絡人同意以上所填個人資料提供組團單位用於展覽會公開發行之大會名錄/會刊，知悉組團單位於運作期間內依個資法規定蒐集、處理及利用本人個人資料(應用區域為全球)，本人亦了解個資法第三條得行使之權利及第八條不同意提供時權益之影響。
- 六、 本公司以上所填相關訊息完全屬實，並為最新資訊。

公司名稱

負責人

(大章)

(小章)

填表日期：西元_____年_____月_____日